



京セラ株式会社 2021年3月期 第3四半期 決算カンファレンスコール
(2021年2月1日実施)

代表取締役社長 谷本 秀夫 スピーチ

<1. (中表紙) 2021年3月期第3四半期 決算概要>

<2. 2021年3月期第3四半期累計 決算概要>

当期は、新型コロナウイルス感染症の影響を主因に、前年同期に比べ減収減益となりました。売上高は8.1%減少の1兆1,005億円、営業利益は54.7%減少の430億円、税引前利益は38.4%減少の872億円、当期利益は36.9%減少の639億円となりました。

平均為替レートは、対米ドルは前年同期に比べ3円円高の106円、対ユーロは1円円安の122円となり、これにより売上高は約100億円、税引前利益は約10億円押し下げられました。

<3. 2021年3月期第3四半期累計 業績サマリー>

当期のサマリーを3点、ご説明します。

1点目は、新型コロナウイルス感染症による主要市場での需要の減少です。ドキュメント市場や自動車関連市場では第1四半期を底に需要は回復基調で推移したものの、第3四半期累計では前年同期に比べ減少しました。

2点目は、「生活・環境」における減損損失115億円の計上です。スマートエナジー事業において、有形固定資産及びのれん等の減損損失を計上しました。当社は同事業の採算改善に向けて、メガソーラーなどの太陽光発電システム事業に加え、自家消費対応として蓄電池をはじめとするシステムの開発及び販売に注力するなど、エネルギー事業への転換を進めています。その一方で、今般の新型コロナウイルス感染症拡大により、客先でのエネルギー関連投資の先送りや対面営業の抑制等の影響もあり、今後の需要見通しに対して遅延が生じています。これらの状況を踏まえ、今後の事業計画を見直し、事業価値を算定した結果、当期に減損損失を計上しました。

3点目は、半導体及び5G関連部品の需要増です。「産業・自動車用部品」では半導体製造装置用ファインセラミック部品の、「半導体関連部品」では5G対応端末向けにイメージセンサー用及び水晶・SAWデバイス用パッケージの需要が増加しました。

<4. 2021年3月期第3四半期累計 事業セグメント別売上高>

事業セグメント別の売上高は、「産業・自動車用部品」及び「半導体関連部品」は増収となりましたが、他のセグメントは減収となりました。

<5. 2021年3月期第3四半期累計 事業セグメント別利益>

利益につきましては、全セグメントで減益となりました。

<6. 2021年3月期第3四半期累計 事業セグメント別業績（1）産業・自動車用部品>

事業セグメント別にご説明します。スライドの左側には第3四半期累計の前年同期比を、右側には第1四半期から第3四半期の推移を記載しています。

「産業・自動車用部品」は、左側の前年同期比ではM&Aの貢献による空圧・電動工具の増収及び半導体製造装置用部品の需要増により売上は増加したものの、利益は自動車関連市場の低迷の影響を主因に減少しました。

右側の四半期推移では、車載カメラや切削工具等の自動車関連部品の需要が回復基調となり、また半導体製造装置用部品の需要も高水準が続いたことから、売上及び事業利益ともに右肩上がりで推移しました。

<7. 2021年3月期第3四半期累計 事業セグメント別業績（2）半導体関連部品>

「半導体関連部品」は、左側の前年同期比では5G関連製品が伸びたことで売上は増加したものの、利益は減価償却費などの増加もあり減益となりました。

一方、右側の四半期推移では、5G対応スマートフォン向けを中心にセラミックパッケージの需要が増加したことを主因に、売上、利益ともに改善が進みました。

<8. 2021年3月期第3四半期累計 事業セグメント別業績（3）電子デバイス>

「電子デバイス」は、左側の前年同期比ではAVX Corporationの減収を主因に減収減益となりました。産業機械や自動車関連市場などの主要市場で需要が低迷しました。

一方、右側の四半期推移では、市場の回復に伴い売上、利益ともに改善が進みました。AVX Corporation及び自動車市場向け水晶部品やコネクタの売上が増加したことに加え、第2四半期以降、5G対応スマートフォン向けにセラミックコンデンサなどの需要が堅調に推移したことや、捺染市場向けプリンティングデバイスの需要が回復しました。

<9. 2021年3月期第3四半期累計 事業セグメント別業績（4）コミュニケーション>

「コミュニケーション」は、左側の前年同期比では通信機器事業及び情報通信サービス事業

ともに減収減益となりましたが、原価低減により事業利益率は上昇しました。

右側の四半期推移では、通信機器事業及び情報通信サービス事業の需要が回復してきたことに加え、原価低減も進んだことから、売上及び利益は増加傾向で推移しました。

<10. 2021年3月期第3四半期累計 事業セグメント別業績(5)ドキュメントソリューション>

「ドキュメントソリューション」は、左側の前年同期比では、オフィスへの出勤抑制に伴う機器及び消耗品の需要減により減収減益となりましたが、右側の四半期推移では、第1四半期を底に世界的に需要の回復が進みました。加えて原価低減や為替の影響もあり、第3四半期の事業利益は大幅に増加しました。

<11. 2021年3月期第3四半期累計 事業セグメント別業績(6)生活・環境>

「生活・環境」は、左側の前年同期比では、太陽光発電システムなどの販売減によりスマートエネルギー事業の売上が減少しました。事業損失は、115億円の減損損失の計上もあり、拡大しました。

右側の四半期推移では、スマートエネルギー事業において、国内市場での営業活動の段階的な再開に伴い、売上は回復傾向で推移しました。事業損失についても、減損損失を除いたベースでは縮小しています。

以上が各セグメントの状況です。続いて、通期の業績予想についてご説明します。

<12. (中表紙) 2021年3月期 業績予想>

<13. 2021年3月期 業績予想>

第4四半期も新型コロナウイルス感染症による影響は懸念されるものの、部品事業においては引き続き5G関連や半導体市場向けの需要が予想されます。また、機器・システム事業においては新製品投入による売上増が見込まれることから、通期業績予想につきましては4月の公表数値から変更はありません。

第3四半期までの進捗及び第4四半期の見通しに鑑み、設備投資額については従来予想の1,000億円から1,100億円へ、研究開発費については800億円から750億円へそれぞれ修正しています。セグメントの予想についても進捗を踏まえ修正しています。

<14. 2021年3月期 事業セグメント別売上高予想>

部品事業は、「電子デバイス」は10月予想を下回るものの「産業・自動車用部品」や「半導体関連部品」は自動車や半導体、5G関連市場での需要が牽引し、10月予想を上回る見通しであることから、部品事業全体では140億円の上方修正となります。

一方、機器・システム事業については、「ドキュメントソリューション」は市場の回復が後押しし、10月予想を上回る見通しですが「コミュニケーション」及び「生活・環境」が下回ることから、機器・システム事業全体では70億円の下方修正となります。

<15. 2021年3月期 事業セグメント別利益予想>

利益予想については、部品事業は、「産業・自動車用部品」の上方修正が「半導体関連部品」及び「電子デバイス」の下方修正をカバーし、部品事業全体では変更ありません。

機器・システム事業は、「生活・環境」における減損損失の影響はあるものの、「ドキュメントソリューション」及び「コミュニケーション」の上方修正により、機器・システム事業全体では10億円の増額となる見通しです。

<16. 成長に向けての事業基盤強化（1）GaN事業への参入>

今後の成長に向けた事業基盤の強化について、2点ご説明します。

1点目は、低炭素社会の実現に向けて期待されている窒化ガリウム、GaN事業への参入です。1月に当社は、同技術を基盤とするレーザー光源の商用化においてリーディングカンパニーである米国SLD Laser社を買収しました。同社のGaNレーザーは、高効率や高出力、高い安全性といった特長を実現しており、モビリティや特殊照明をはじめ、さまざまなアプリケーションに採用されています。当社は今後、SLD Laser社の製品や技術を活用し、デバイスやシステムの開発を加速するとともに、当社の生産技術を活かし、更なる生産性及び収益性の向上を図ります。

<17. 成長に向けての事業基盤強化（2）研究開発体制の強化>

2点目は、研究開発体制の強化です。当社は、2019年に横浜みなとみらい地区へ関東地域に点在していたソフトウェア開発を集約しましたが、今般、ものづくり開発の拠点である鹿児島国分工場において、開発のスピードアップとオープンイノベーションや人材育成の推進を目的に、新たな研究棟を建設することを決定しました。同工場内には材料技術やプロセス技術、解析評価技術の3部門があり、これらを新棟に集約させることで、情報通信や環境・エネルギーに加え、航空・宇宙や医療・ヘルスケアといった新規分野への開発の一層のスピードアップを図ります。

<18. 2022年3月期の事業環境見通し及び取り組み>

2022年3月期（来期）も新型コロナウイルス感染症による影響は懸念されるものの、デジタル化やADASなどの更なる進展を見込んでいます。当社はこれらの事業機会を捉えるべく、引き続き積極的な製品展開と新製品開発に取り組んでまいります。デジタル化の進展に対しては、5Gや半導体関連市場向け製品の拡販を図ります。当社はこの数年、同市場での

事業拡大を見据え、積極的に増産のための設備投資や自社への新システムの試験導入を進めてきました。これらを着実に来期の収益につなげてまいります。

モビリティ市場については、グループの総合力を活かし、各種製品の拡販に努めます。ADASの実現を支える車載カメラやモジュールなどの部品やデバイスから、路側機などのシステムまで、これまで各事業で培った技術の活用と連携により、幅広い製品展開を図ります。

<19. (中表紙) 組織再編について>

<20. (1) 経営基盤の強化に向けた組織再編の実施>

2021年4月より、現在16ある主要事業・子会社を、新設する「コアコンポーネント」、「電子部品」、「ソリューション」の3事業セグメントの下に、管理部門を「コーポレート」に集約し、それぞれに担当役員を任命する予定です。

2021年4月以降、新たな組織体制のもと、既存組織の枠を超え、ダイナミックでスピーディーな経営判断を実践してまいります。

<21. (2) 事業セグメント区分の変更>

事業セグメント区分の変更内容を示しています。左側が今期までの事業区分です。16の事業部門を6つの事業セグメントにグルーピングしていましたが、来期以降は、右側に示しましたとおり、3つの事業セグメントに変更します。

「コアコンポーネント」は、主に従来の「産業・自動車用部品」や「半導体関連部品」から構成されます。「電子部品」は、現在の「電子デバイス」に含まれている電子部品とAVXから構成されます。「ソリューション」は、主にこれまでの「コミュニケーション」や「ドキュメントソリューション」に加え、機械工具やプリンティングデバイス、スマートエナジーなどで構成されます。

今後、担当役員を中心に各セグメントの成長及び収益拡大に向けて、製品や事業の見直しを行うとともに、事業部門内及び事業部門間の連携強化に努めてまいります。

以上

将来事象に関する注意事項

当資料には、将来の事象についての2021年3月期第3四半期決算カンファレンスコール開催日(2021年2月1日開催)時点における当社グループの期待、見積り及び予測に基づく記述が含まれています。これらの将来の事象についての記述には、既知及び未知のリスク、不確実な要因並びにその他の要因が内包されており、当社グループの将来における実際の財政状態及び活動状況が、当該将来の事象についての記述によって明示または黙示されているところと大きく異なる場合があります。